

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币173,832,028.54元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币30,148,456.12元（包括：审计费及验资费12,467,000.00元、律师费10,904,467.37元、用于本次发行的信息披露费用4,575,471.70元、发行手续费及材料制造费等2,201,517.05元），募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。

上述募集资金于2021年11月12日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金存储情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	初始存放金额 (人民币元) (注1)	截止日余额 (人民币元) (注2)	备注
招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121909929210918	700,000,000.00	76,791,501.01	活期存款
中国光大银行股份有限公司 上海昌里支行	36750180808738885	450,000,000.00	26,203.87	活期存款
中国银行股份有限公司 上海市张江高科技园区 支行	452082279585	325,000,000.00		已销户
上海银行股份有限公司 张江支行	03004750062	325,000,000.00		已销户
招商银行股份有限公司 上海陆家嘴支行	121909929210858	200,000,000.00	112,213,558.86	活期存款
上海浦东发展银行股份 有限公司黄浦支行	97080078801900002063	300,000,000.00	8,645,886.31	活期存款
招商银行股份有限公司 上海淮海支行	121909929210202	311,406,976.46	100,701,887.61	活期存款
	12190992927900037		147,245,672.00	通知存款
兴业银行股份有限公司 上海市北支行	216420100100156371	300,000,000.00	650,048.89	活期存款
宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	70090122000444066	300,000,000.00	82,414.55	活期存款
中国工商银行股份有限 公司上海市滴水湖支行	1001747729300001088	300,000,000.00	83,167.33	活期存款
招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121938866210666		6,697,584.65	活期存款
合计		3,511,406,976.46	453,137,925.08	

注1：初始存放金额为募集资金总额3,685,239,005.00元扣除承销商保荐及承销费用173,832,028.54元之后的金额。

注2：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额653,137,925.08元差异200,000,000.00元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额，详见本报告（四）、暂时闲置募集资金使用情况。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。

本公司于2023年8月3日分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目“高端半导体设备拓展研发项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司于2022年3月1日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币209,203,489.29元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币8,636,173.92元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币217,839,663.21元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事对本事项发表了意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了专项核验，并出具了《盛美半导体设备（上海）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZI10013号）。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-009）。

截至2024年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

本公司于2022年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

本公司于2023年8月3日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次

会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。

截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额（元）	年化收益率
兴业银行股份有限公司上海市北支行	大额存单	2023.1.31	2026.1.31	100,000,000.00	3.15%
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	结构性存款	2024.3.15	2024.9.11	100,000,000.00	1.50%至2.80%
合计				200,000,000.00	

本公司于2024年6月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。截至2024年6月30日，本公司可使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为25,000.00万元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2024年6月30日，公司前次募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元，尚未使用募集资金人民币653,137,925.08元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的18.76%。

尚未使用的原因：公司募集资金投资项目现阶段尚处于建设期。

剩余资金的使用计划和安排：公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

盛美半导体设备研发与制造中心项目目前仍在建设中，尚未产生效益。

盛美半导体高端半导体设备研发项目以及高端半导体设备拓展研发项目不直接产生效益，旨在进一步完善公司的研发体系，增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司生产技术水平提高、工艺流程改进、新产品快速投放所带来的生产成本的降低和盈利水平的提升，有利于巩固和提升公司的市场地位。

盛美韩国半导体设备研发与制造中心项目资金尚未投入，未产生效益。

补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、 报告的批准报出

本报告于2024年10月21日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2024年10月22日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：			3,481,258,520.34			已累计使用募集资金总额：			2,934,687,531.53	
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2021 年：			679,648,369.37	
						2022 年：			936,794,577.03	
						2023 年：			796,267,068.18	
						2024 年 1-6 月：			521,977,516.95	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	止日项目完工程 度)
1	盛美半导体设备研发与 制造中心项目（注 1）	盛美半导体设备研发与 制造中心项目	700,000,000.00	1,200,000,000.00	1,094,425,242.66	700,000,000.00	1,200,000,000.00	1,094,425,242.66	-105,574,757.34	预计达到可使用状 态的日期为 2025 年 6 月
2	盛美半导体高端半导体 设备研发项目（注 2）	盛美半导体高端半导体 设备研发项目	450,000,000.00	450,000,000.00	454,561,294.44	450,000,000.00	450,000,000.00	454,561,294.44	4,561,294.44	不适用（注 5）
3	补充流动资金	补充流动资金	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00		不适用（注 5）
4	高端半导体设备拓展研 发项目（注 3）	高端半导体设备拓展研 发项目		730,871,500.00	735,700,994.43		730,871,500.00	735,700,994.43	4,829,494.43	不适用（注 5）
5	盛美韩国半导体设备研 发与制造中心（注 4）	盛美韩国半导体设备研 发与制造中心		245,000,000.00			245,000,000.00		-245,000,000.00	资金尚未投入
合计			1,800,000,000.00	3,275,871,500.00	2,934,687,531.53	1,800,000,000.00	3,275,871,500.00	2,934,687,531.53	-341,183,968.47	

注 1：盛美半导体设备研发与制造中心项目：本公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》，同意使用超募资金人民币 50,000.00 万元用于公司募集资金投资项目建设及调整募

项目实施进度。该议案于 2023 年 11 月 28 日经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-043）。

本公司于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，结合项目进展实际情况，为保障募集资金投资项目顺利开展，公司决定将项目达到预定可使用状态的时间再次延期至 2025 年 6 月。详见公司于 2024 年 6 月 27 日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。

注 2：盛美半导体高端半导体设备研发项目：实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 3：高端半导体设备拓展研发项目：本公司于 2022 年 8 月 4 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用 74,773.07 万元（含利息收益）用于投资建设新项目“高端半导体设备拓展研发项目”，其中使用超募资金人民币 73,087.15 万元。该议案于 2022 年 9 月 8 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-019）。实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 4：盛美韩国半导体设备研发与制造中心：本公司于 2023 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司以超募资金人民币 24,500.00 万元（折合韩元约 462.95 亿，暂以董事会审议日汇率测算，具体外币金额以增资当日汇率为准）向全资孙公司 ACM Research Korea CO., LTD.（“盛美韩国”）增资以新建并实施“盛美韩国半导体设备研发与制造中心”项目，并同意通过技术许可的方式，将现有成熟技术授权于盛美韩国，应用到本项目的研发生产中。该议案于 2023 年 3 月 29 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的公告》（公告编号：2023-015）。

注 5：“盛美半导体高端半导体设备研发项目”、“高端半导体设备拓展研发项目”、“补充流动资金”达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）为不适用，主要原因系前述募集资金投资项目不涉及工程建设。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	盛美半导体设备研发与制造中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	盛美半导体高端半导体设备研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	高端半导体设备拓展研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	盛美韩国半导体设备研发与制造中心	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用